

DR ILL CHART												
SYM	DIAM	TOL	QTY	NOTE								
Δ	0.200 mm		161									
×	0.800 mm		10									
+	1.100 mm		2	NON-PLATED								
♦	1.100 mm		11									
Ø	1.200 mm		70									
#	1.300 mm		6	NON-PLATED								
Ф	1.600 mm		8									
0	3.500 mm		6									
	TOTAL	-	274									

MATI	ERIALE												
TIPOLOGIA CIRCUITO				SUPPORTO			SF	SPESSORE RAME					
☐ MONOFACCIA				☐ FR2			X LATI	ESTERNI 35u					
X DOPPIA FACCIA				X FR4			☐ LATI	I INTERNI					
MULTISTRATO				ALTRO			SPESSORE SUPPORTO						
N°LAYERS 2								1.6 mm					
TRAT	TRATTAMENTI												
RAME DI RIPORTO ELETTROLITICO MIN. 20u													
PLACC.ELETT. SURFUSO Sn/Pb 60/40-70/30 Sp.10-20u													
□PLACC.ELETT. RIFUSO Sn/Pb 60/40-70/30 Sp. 4-15u													
RAME PASSIVATO MHOT AIR LEVELING													
□DO	□DORATURA(D=140±vPN) □0.3u □0.6u □1,0u □1,3u □2,0u												
BIS	SELLAT	JRA				NUM	ERO DEI	CC	TTATM	l			
DE	POSITO	DI GF	RAFI	TE		NUM	ERO DEI	CC	NTATT	Ι			
SOLDER RESIST SERIGRAFIA													
Псг			_		SERIGRAFIA								
SERIGRAFICO Sp.						LATO COMP.COLORE BIANCO							
FOTOGRAFICO Sp. 13-100u LATO SALD. COLORE COVER LAYERSp. 25-76u													
	VLIX L	AT LINOP). <u> </u>										
	RAZ. P	EI FORI ARTICO	DLAF		A	FILE SSOC	S DI DOC IATI PER	LA	IENTAZ LAVOR	ZIONE RAZIONE			
TIPO	ø MET.	ø N.MET.	Q.T.	A'	LA	YER	вот	X	22-30	5-0.BOT			
Α					LA	YER	TOP	X	22-30	5-0.TOP			
В					LA	YER	PWR						
С					LA	YER	GND						
D					SERIG. BOT								
Е					SERIG. TOP		X	22-30	5-0SST				
F					LAYER IN1								
G					L	AYEF	R IN2						
Н					LA	AYEF	R IN3						
I					L/	4YEF	R IN4						
L					RE	SIST	ВОТ	X	22-30	5-0.SMB			
М					RE	SIST	TOP	X	22-30	5-0.SMT			
NOTE PARTICOLARI				PAST BOT		вот							
				PAST TOP		X	22-30	05-0.SPT					
					LAYER FOR.		X						
					DRILL CHART			X	22-30	05-0.DRD			
					DRILL TAPE			X	22-30	05-0.TAP			
TUTTI I FORI NON INDICATI DEVONO ESSERE METALLIZATI					ME	MECC.DRW.		□	PF22-3	05-0.DWG			
	JEINE P	vi L I / \ L L l	Z/\	ا ل'									

